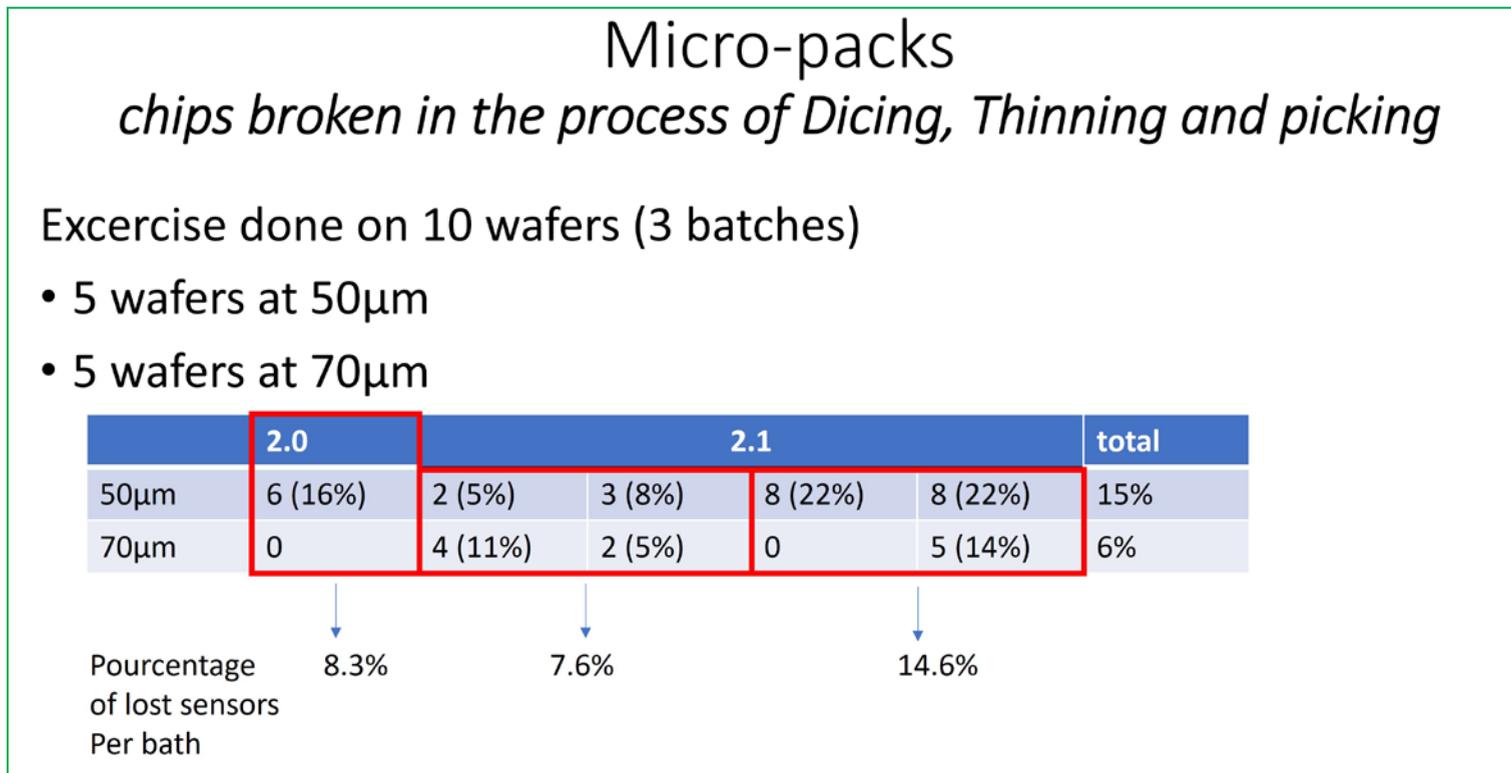


- ❑ 9 wafers entier (**3 with 50µm epitaxial layer**)
- ❑ 5 Pads wafer (**pure mécanique – only the two last metal layers**)

Découpe, amincissement et prélèvements du capteur Mimosis aminci

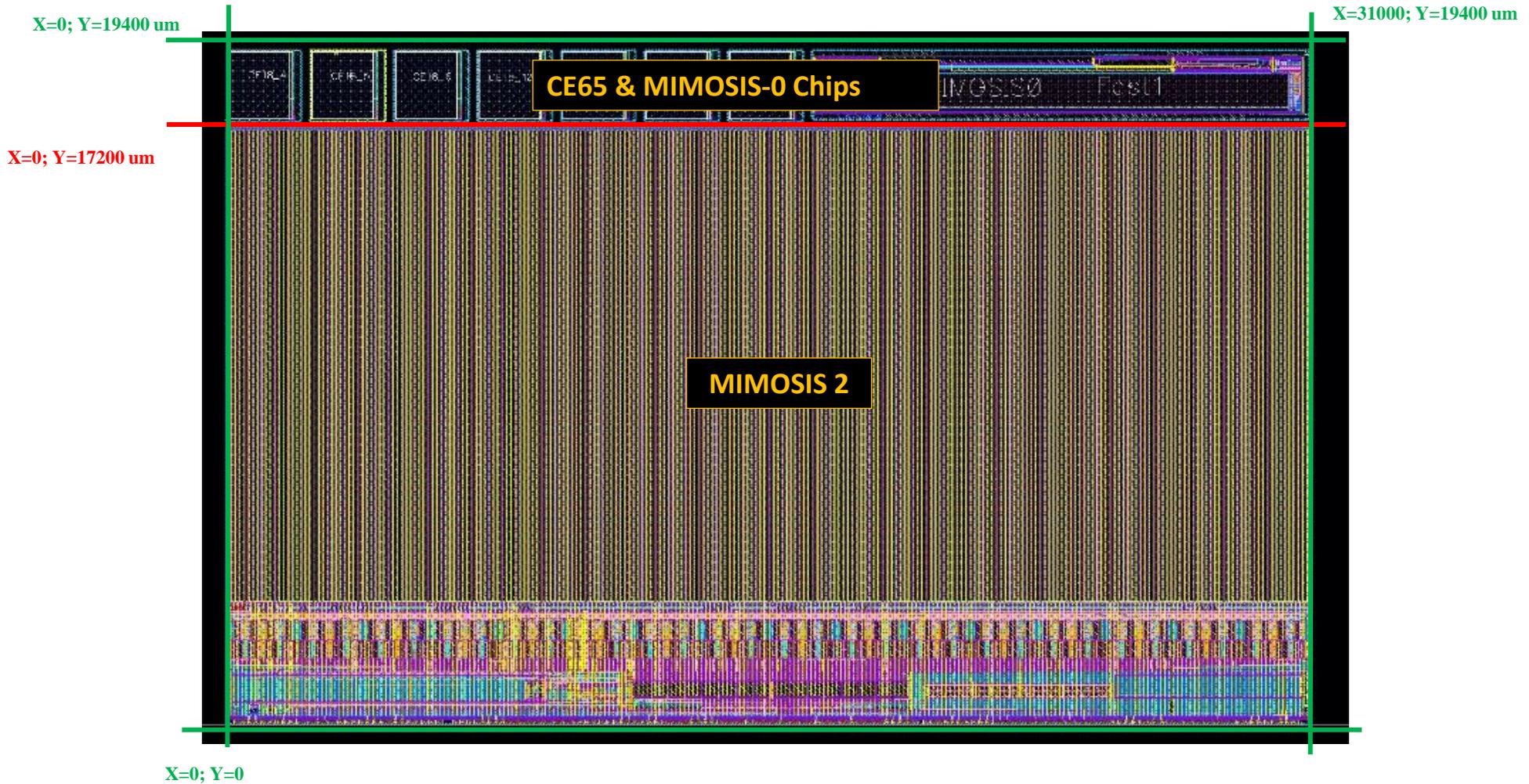
- Des problèmes de rendements sont apparus lors des demandes dans le cadre du projet CBM/MVD



- Après une discussion avec la compagnie Micro-Packs, il s'avère que entre le deuxième et le troisième lot d'amincissement, ils ont insolés plus le film bleu de rétention pour faciliter le prélèvement mais cela a eu pour conséquence que la petite barrette de capteurs au-dessus de Mimosis ce détachait et allait abimer le Mimosis.

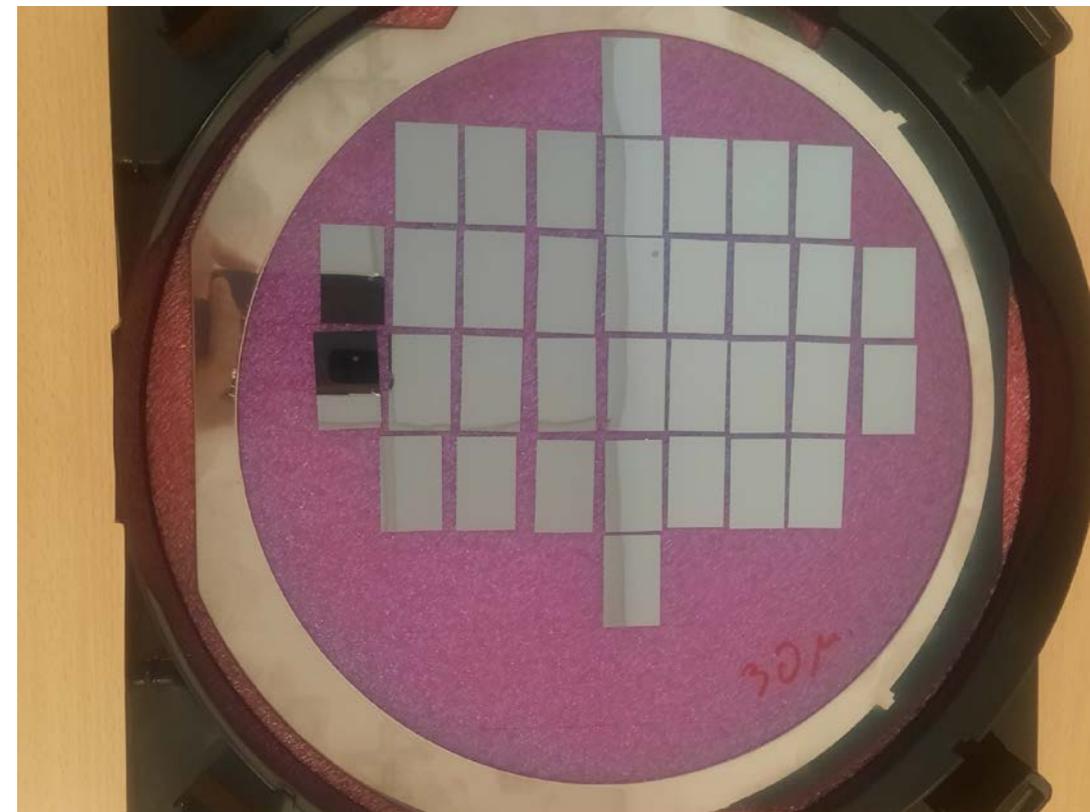
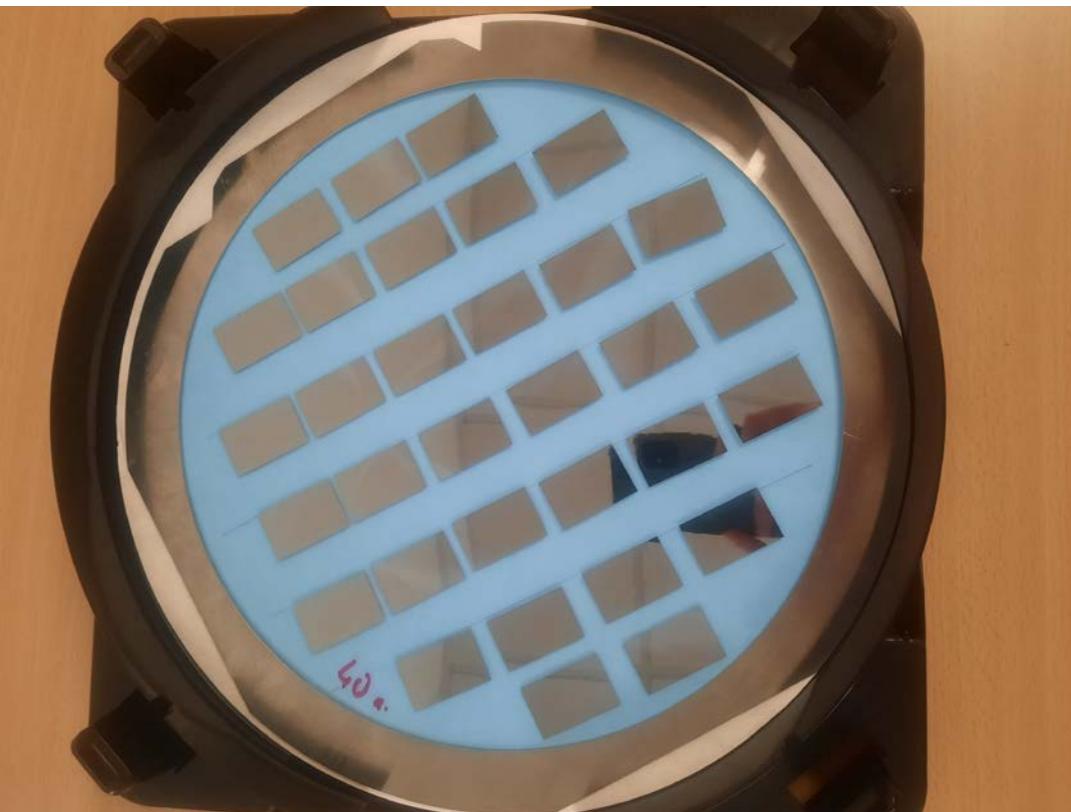
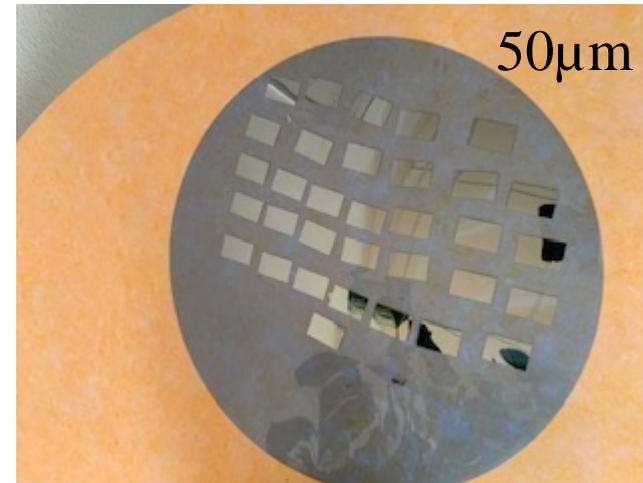


Décision de faire l'exercice sans découper cette barrette
→ cela fait passer la puce de 17.2 mm à 19.4 mm de hauteur



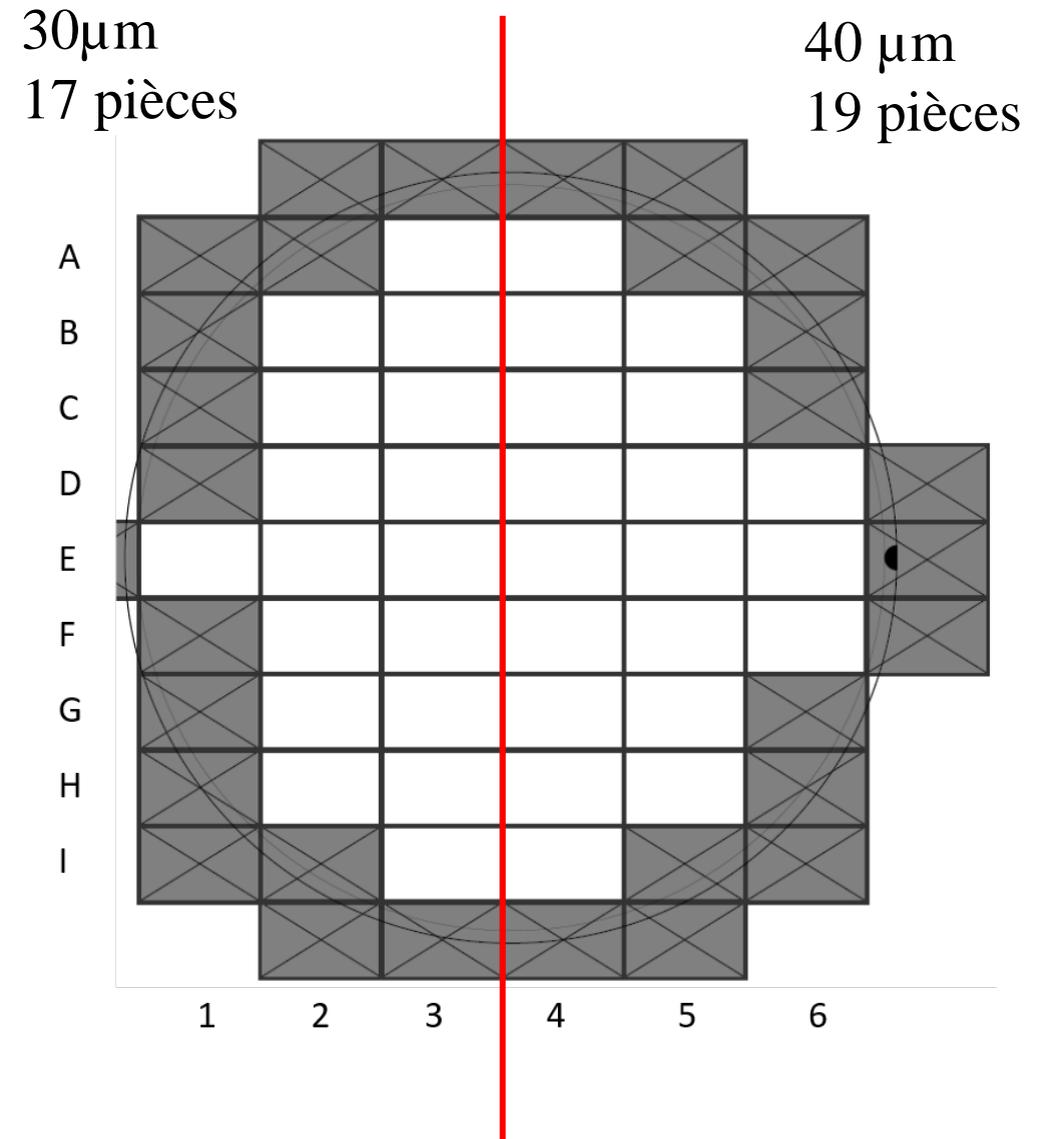
Exercice de Micro-Packs sur des wafers de silicium sans la découpe de la bande supérieur

👍 Pas de casse



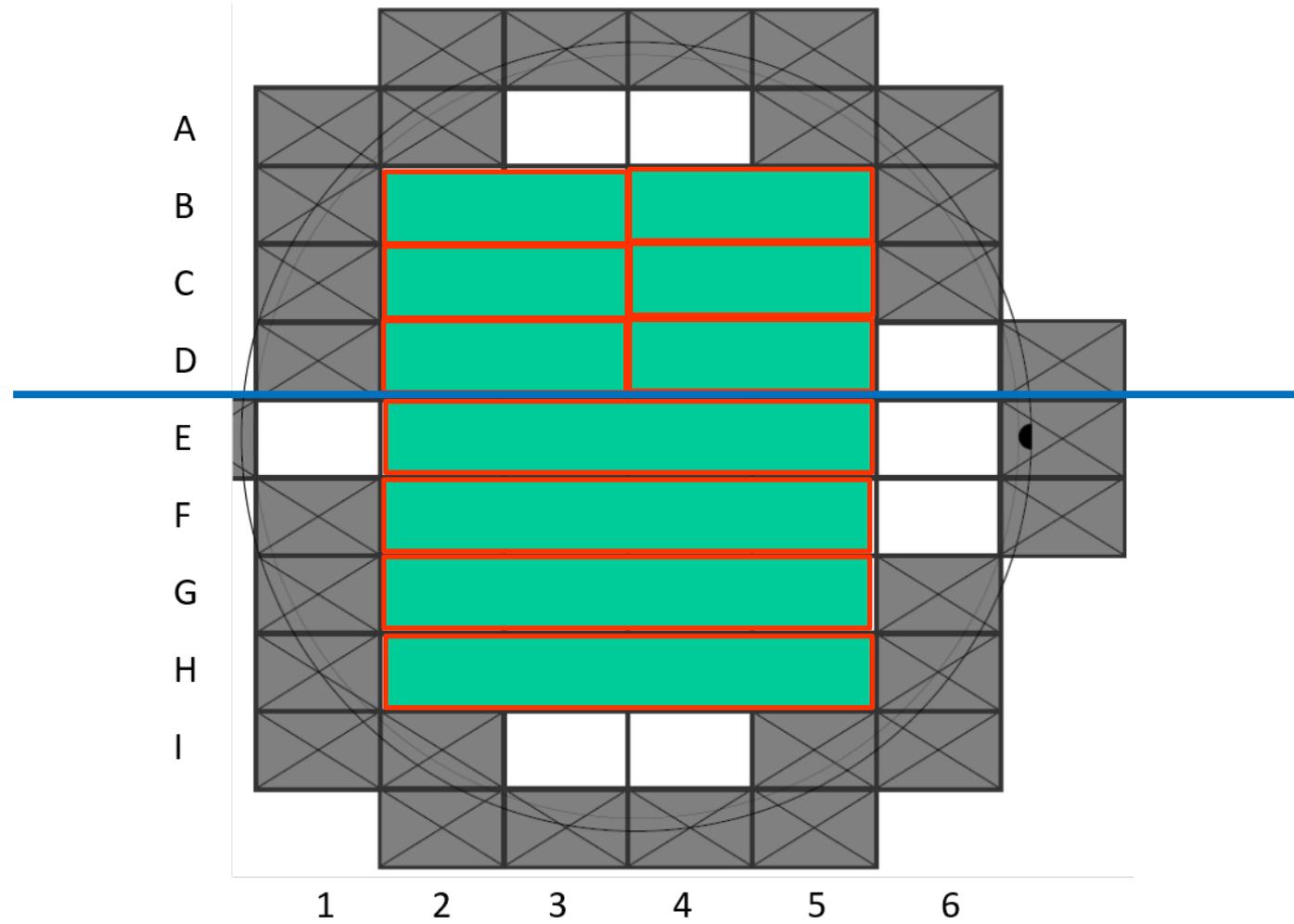
- Une cotation a été faite pour avoir les réticules capteurs Mimosis aminci à 40 et 30µm (demi wafer de chaque épaisseur)
 - 1 wafer normal (fonctionnel)
 - 1 Pad Wafer (mécanique) (2 metal layers only)
- Nouvelle boîte de transport a été dessiné et imprimé par Olivier
- Envois des wafers et des boites cette semaine
- Demande pour aussi récupérer les puces silicium de leur exercice (pas encore de confirmation)

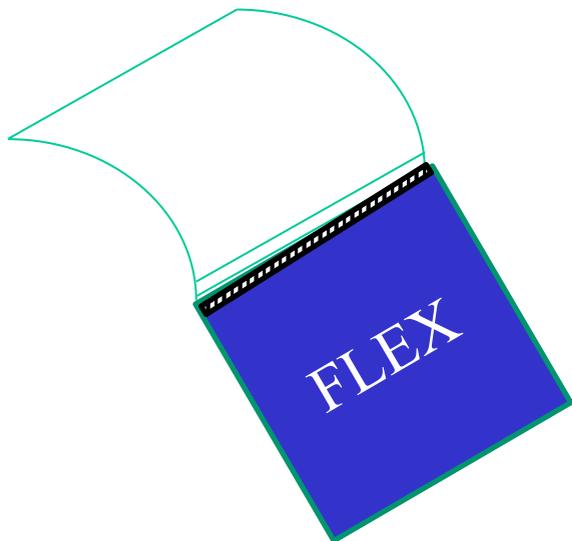
Stock puces	30µm	40µm	50µm
Silicium pure	36	36	36
Pad sensors	17	19	
Puces fonctionnelle	17	19	



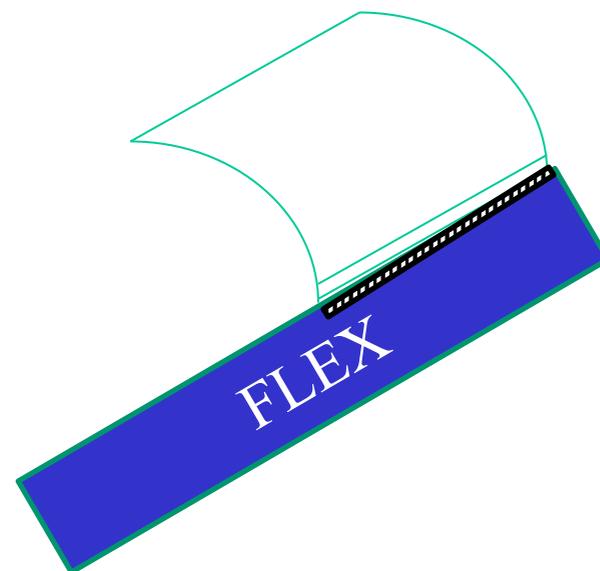
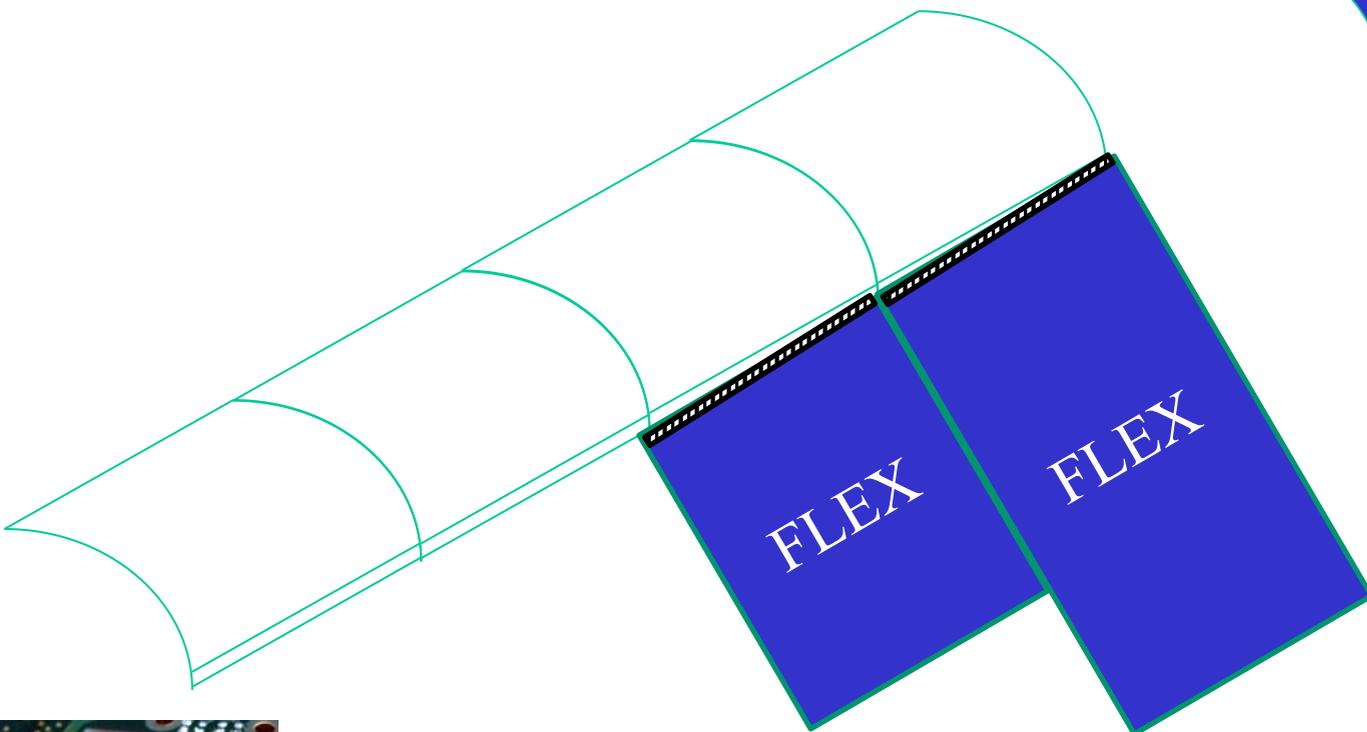
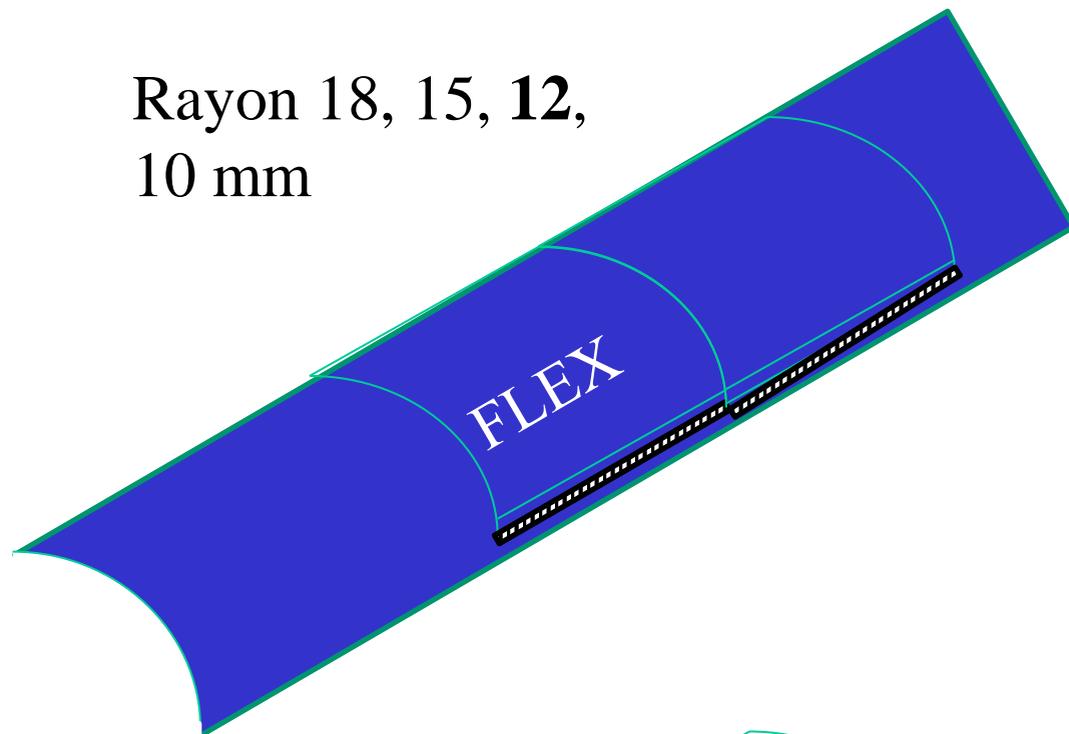
SPARE

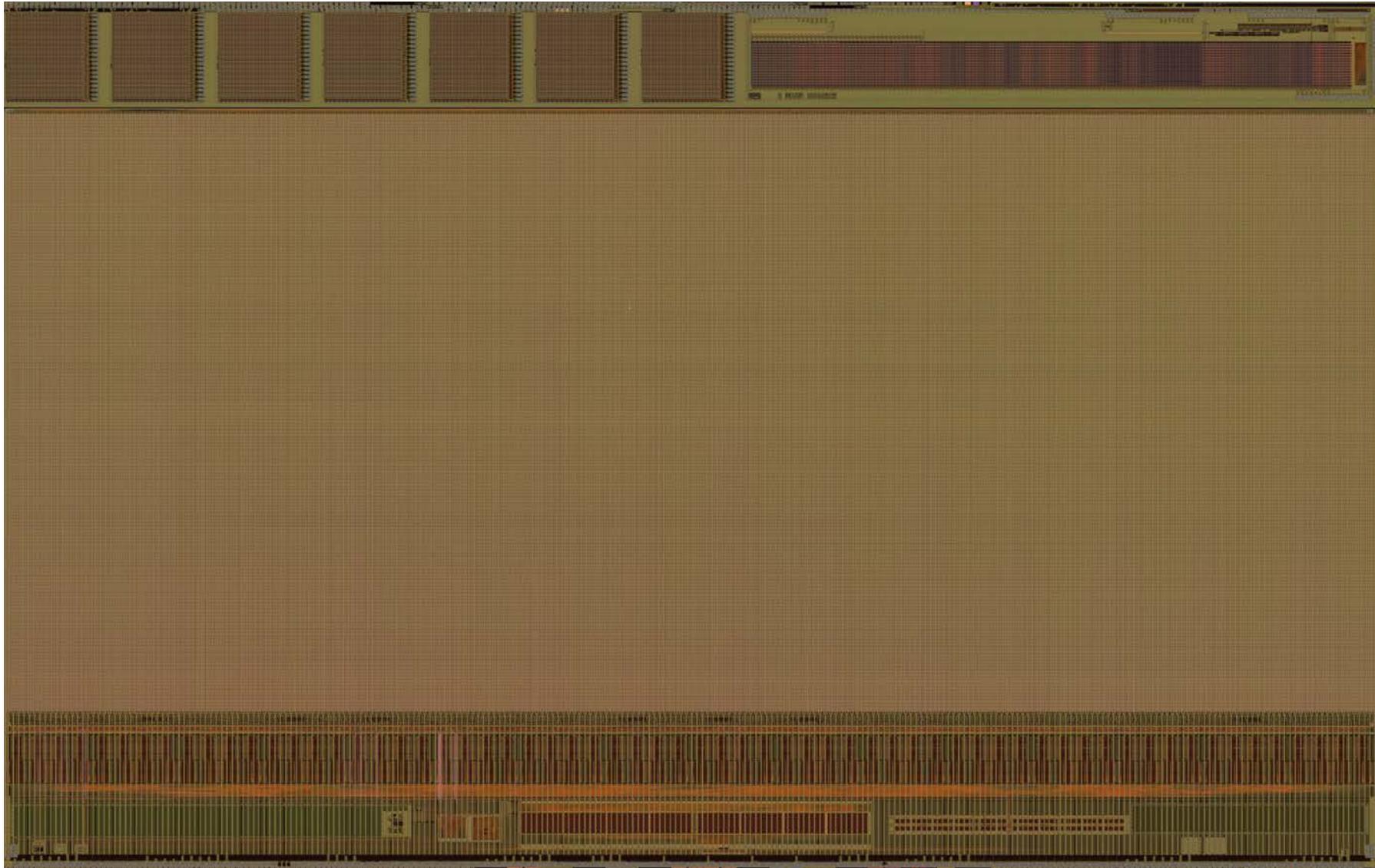






Rayon 18, 15, 12,
10 mm





PADs

Reticule entier

